

目录

1. 概述.....	2
2. 产品特性.....	3
3. 系统框图.....	5
4. 管脚定义.....	6
5. 参考原理图.....	8
6. 封装尺寸图.....	9
版本历史.....	11

1. 概述

RW1626BF使用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型无线MCU，最高工作频率为32MHz，内部有32K/16K Bytes FLASH程序存储器，256 Bytes IRAM和1024 Bytes XRAM，最多14个双向I/O口，5个16位定时器/计数器，3组16位带死区控制互补PWM，1个8位PWM，2个UART，1个SPI，1个IIC，10个外部中断，7路12位ADC，四种系统工作模式（正常、低频、掉电和空闲）和10个中断源，无线通信接口：2.4GHz 无线收发电路，其嵌入了基带通讯协议，工作在2.4~2.483GHz通用的ISM频段。

RW1626BF内核工作电压为2.9V至5.5V，无线通讯电路可工作在1.8至3.6V，工作温度-40℃至+85℃。一系列的省电模式，及片内的电压调节器，保证了低功耗应用的要求。

RW1626BF提供16脚(SOP16)和24脚(QFN24)两种封装形式。

这些丰富的外设配置，使得RW1626BF适合于多种应用场合：

电机驱动和应用控制

医疗和手持设备

PC游戏外设和GPS平台

无线航模，无线车模

智能照明，智能家居

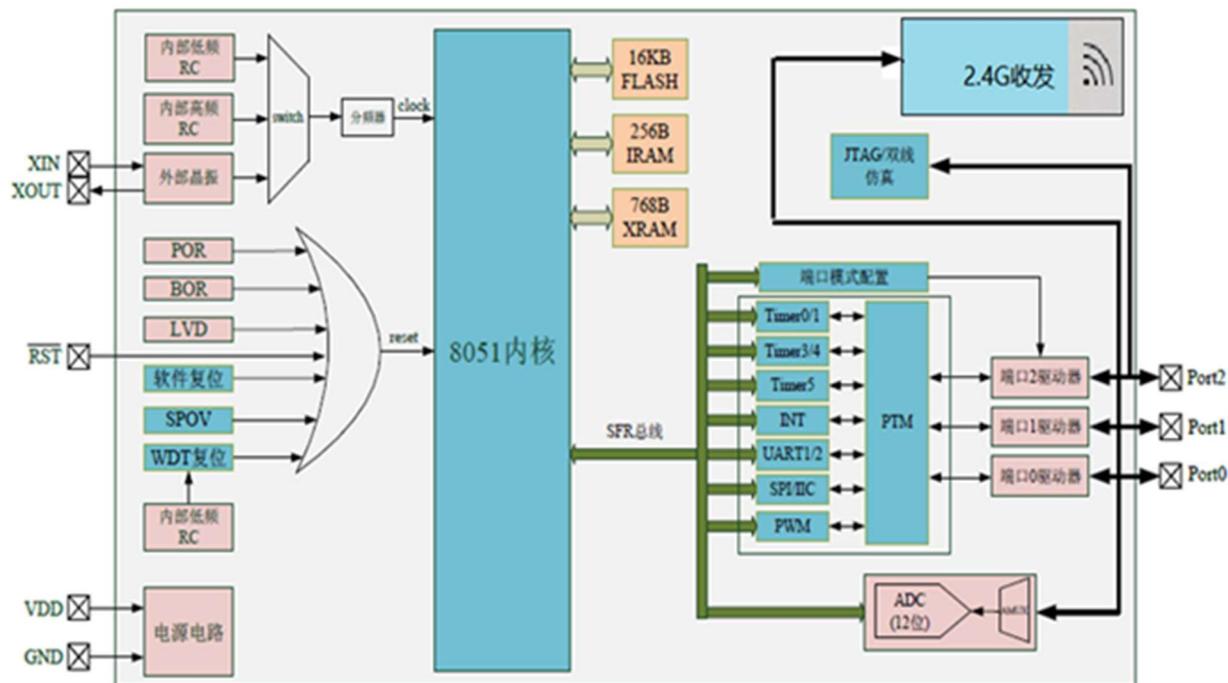
有源电子标签

2. 产品特性

- 内核：
 - 增强型 1T 8051 内核
- 存储器
 - 高达32K/16K字节的闪存程序存储器
 - 高达1280字节的RAM, 分别是 256字节的IRAM, 1024字节的 XRAM
- 时钟、复位和电源管理
 - 2.9~5.5伏宽电压供电
 - 上电/断电复位(POR/PDR)、多级低压复位, 外部引脚低电平复位, 堆栈异常复位.
 - 可接外部4-16MHz的高频晶振, 外部32.768KHz的低频晶振.
 - 内嵌高精度的32MHz的RC振荡器
 - 内嵌44kHz的RC振荡器
 - 多种时钟输出
- 低功耗
 - 睡眠、停机和待机模式
- 1个12位模数转换器, 1 μ s转换时间(多达8个输入通道)
 - ADC参考电压可选内部VREF、外部VREF、VDD
 - 具有省电唤醒功能(单通道)
- 循环冗余校验(CRC)
- 多达10个I/O端口
 - 多种模式可配: 输入、带上拉输入、带下拉输入、施密特输入、模拟输入、强推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出
 - 外设功能引脚全映射模块PTM
- 调试模式
 - 串行双线调试接口
- 多达5个定时器
 - T0/T1兼容标准8051, 16位自动重载
 - T3可以工作在掉电模式
 - T4可以使用外部信号触发定时
 - T5带捕获功能
- PWM
 - 最多3组16位带死区控制互补PWM
 - 可配置为6路独立输出
 - 可当定时器使用
 - 具有故障检测功能
 - 可配置边沿对齐或中心对齐
 - 1路8位单输出PWM

- 3个通信接口
 - 1个I2C接口
 - 2个UART接口
 - 1个SPI接口
- 高性能2.4G收发器
 - 2.4GHz 的世界通用ISM频段
 - 126个射频频道
 - GFSK 调制方式
 - 支持多种空口传输速率：1Mbps
 - 可编程的发射功率：+8dBm, +5dBm, +4dBm, +3dBm, 0dBm, -6dBm, -12dBm, -18dBm
 - 工作电流：发射功率0dBm时，17mA；接收模式工作电流18mA
 - 空口速率1MHz时，接收灵敏度为-90dBm
 - 片内集成频率合成器，可接受±20ppm的低成本16MHz晶体
 - 内置硬件协议栈，可自动数据包处理及发送
 - 集成可兼容蓝牙的MESH协议栈，可实现多对多的通讯应用

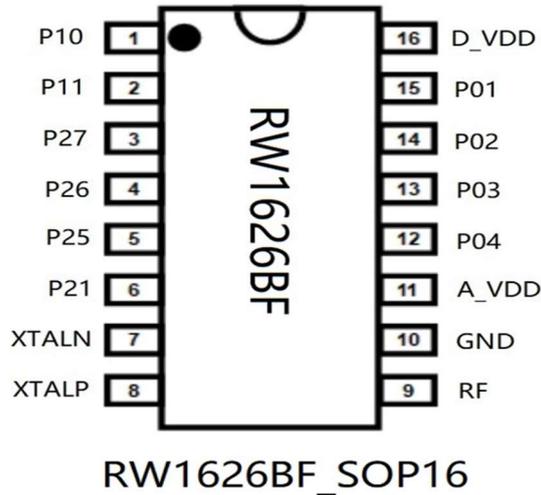
3. 系统框图



1626BF系统框图

4. 管脚定义

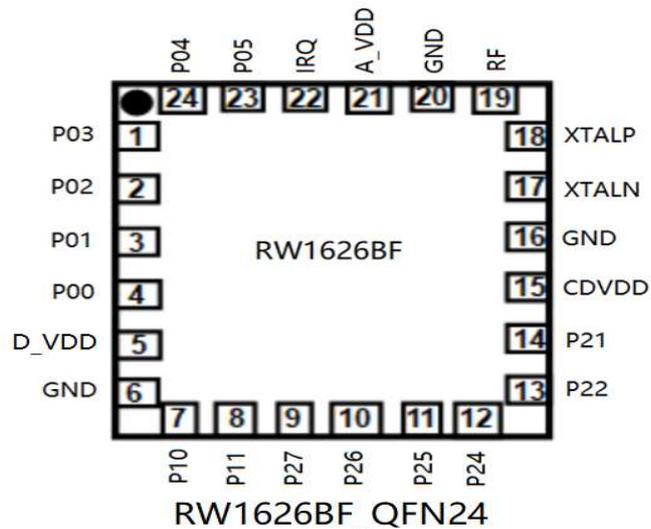
RW1626BF-SOP16



RW1626BF_SOP16 管脚信息

引脚号	引脚名称	类型	默认功能
1	P1.0/XIN	I/O	输入输出口, 晶振输入口
2	P1.1/XOUT	I/O	输入输出口, 晶振输出口
3	P2.7/AN15/RST	I/O	输入输出口, ADC15 输入口, 复位输入口
4	P2.6/PLVD	I/O	输入输出口, 低压检测端口
5	P2.5/AN13	I/O	输入输出口, ADC13 输入口
6	P2.1/AN9/SDA	I/O	输入输出口, ADC9 输入口, 双线数据输入输出口
7	XTALN	O	RF 晶振
8	XTALP	I	RF 晶振
9	RF	I	天线
10	GND	P	地
11	A_VDD	P	RF 电源, 1.8~3.6V
12	P0.4/AN4	I/O	输入输出口, ADC4输入口
13	P0.3/AN3/SCK	I/O	输入输出口, ADC3输入口, 双线时钟输入口
14	P0.2/AN2/FLT2	I/O	输入输出口, ADC2 输入口, PWM2 故障检测输入口
15	P0.1/AN1/FLT1	I/O	输入输出口, ADC1 输入口, PWM1 故障检测输入口
16	D_VDD	P	数字电源, 2.9~5.5V

RW1626BF-QFN24

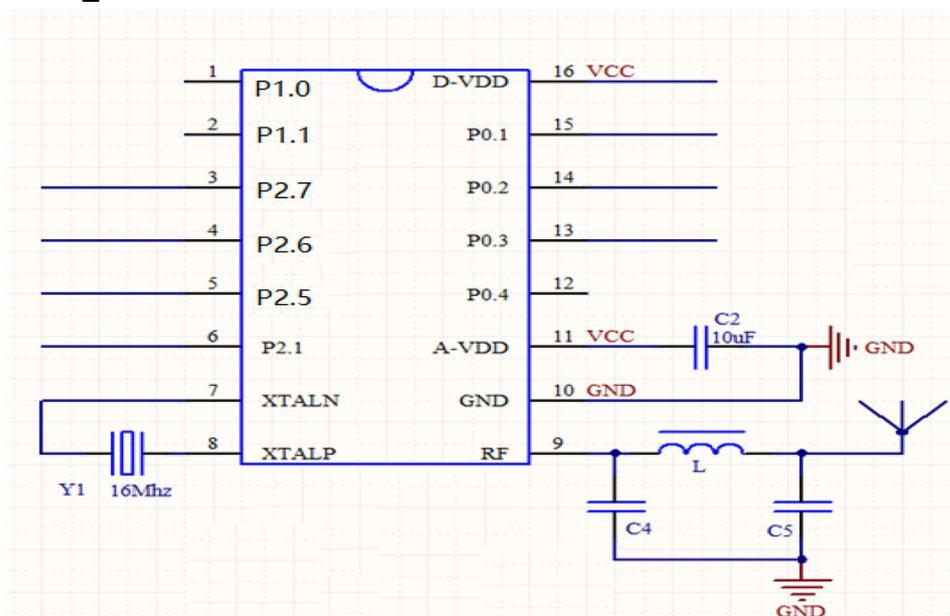


RW1626BF_QFN24 管脚信息

引脚号	引脚名称	类型	默认功能
1	P0.3/AN3/SCK	I/O	输入输出口, ADC3输入口, 双线时钟输入口
2	P0.2/AN2/FLT2	I/O	输入输出口, ADC2 输入口, PWM2 故障检测输入口
3	P0.1/AN1/FLT1	I/O	输入输出口, ADC1 输入口, PWM1 故障检测输入口
4	P0.0/AN1/FLT1	I/O	输入输出口, ADC0 输入口, PWM0 故障检测输入口
5	D_VDD	P	数字电源, 2.9~5.5V
6	GND	P	地
7	P1.0/XIN	I/O	输入输出口, 晶振输入口
8	P1.1/XOUT	I/O	输入输出口, 晶振输出口
9	P2.7/AN15/RST	I/O	输入输出口, ADC15输入口, 复位输入口
10	P2.6/PLVD	I/O	输入输出口, 低压检测端口
11	P2.5/AN13	I/O	输入输出口, ADC13输入口
12	P2.4/AN12	I/O	输入输出口, ADC12输入口
13	P2.2/AN10	I/O	输入输出口, ADC10输入口
14	P2.1/AN9/SDA	I/O	输入输出口, ADC9输入口, 双线数据输入输出口
15	CDVDD	P	电源输出
16	GND	P	地
17	XTALN	O	RF 晶振
18	XTALP	I	RF 晶振
19	RF	I	天线
20	GND	P	地
21	A_VDD	P	RF 电源, 1.8~3.6V
22	IRQ	O	RF 中断信号
23	P0.5/AN5	I/O	输入输出口, ADC5输入口
24	P0.4/AN4	I/O	输入输出口, ADC4输入口

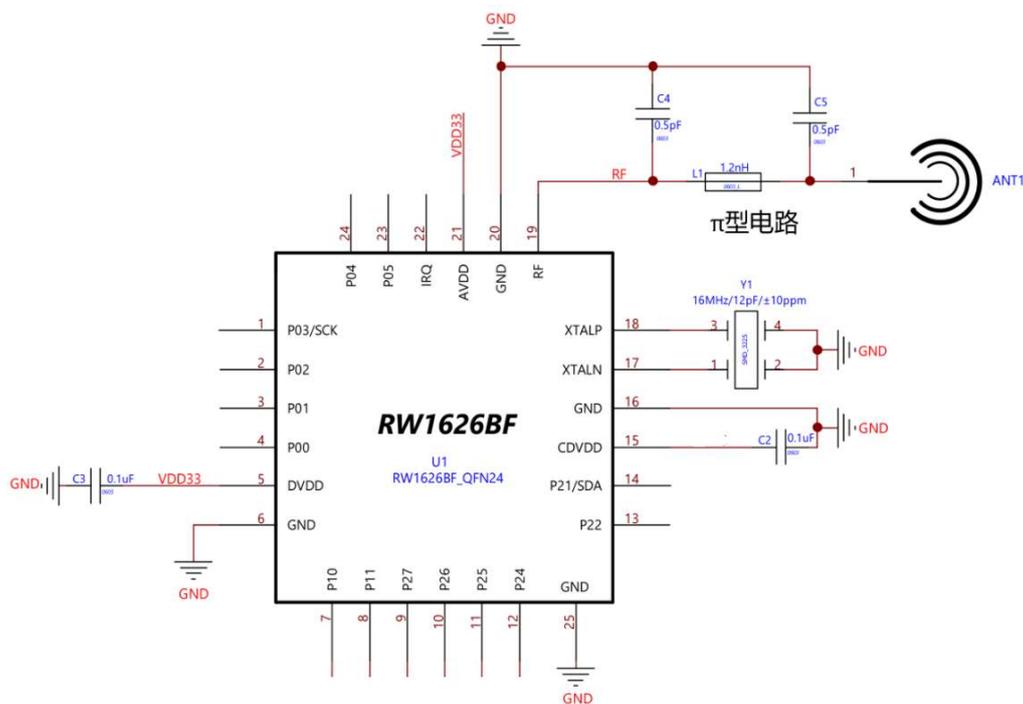
5. 参考原理图

RW1626BF_SOP16



RW1626BF-SOP16 最小系统原理图

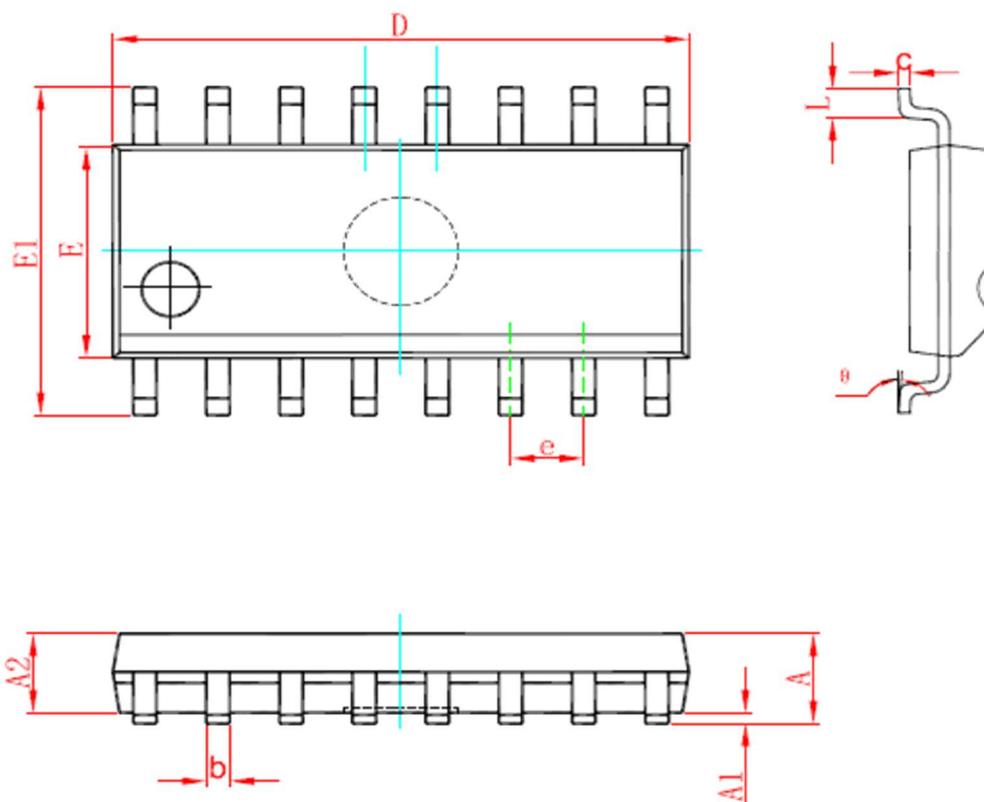
RW1626BF_QFN24



RW1626BF-QFN24 最小系统原理图

6. 封装尺寸图

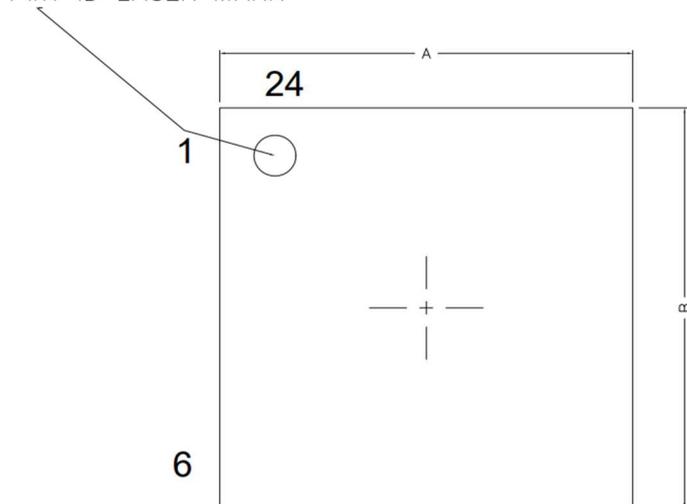
SOP16 封装尺寸图



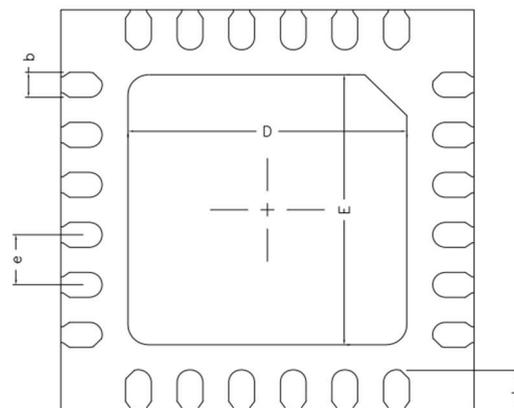
Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	9.800	10.200	0.386	0.402
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	0.800	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

QFN24 封装尺寸图

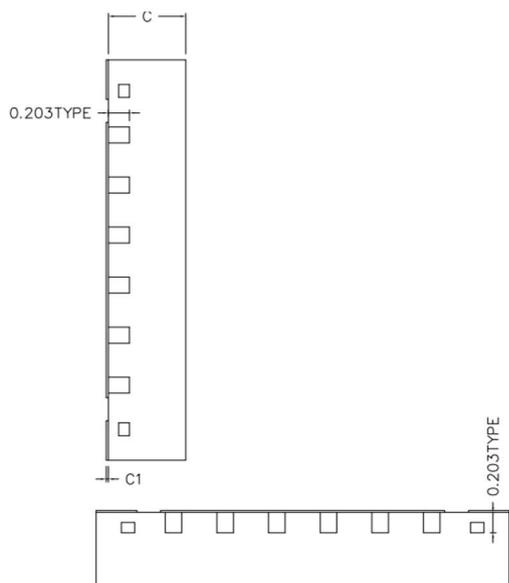
Pin1 ID LASER MARK



TOP VIEW



BOTTEM VIEW



SIDE VIEW

COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE IS mm)

	MIN	NORMAL	MAX
A	3.900	4.000	4.100
B	3.900	4.000	4.100
C	0.700	0.750	0.800
C1	0.005	—	0.020
D	2.650	2.700	2.750
E	2.650	2.700	2.750
L	0.350	0.400	0.450
b	0.200	0.250	0.300
e	0.500 TYPE		

版本历史

版本	日期	描述
V1.0	2023.06.13	创建此文档
V1.1	2023.08.21	增加 QFN24 封装资料